

Title (en)

PROCESS AND DEVICE FOR SOLDERING THE LEADS OF SMD COMPONENTS.

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM LÖTEN VON DRÄHTEN VON BAUELEMENTEN ZUR MONTAGE AUF OBERFLÄCHEN.

Title (fr)

PROCEDE ET DISPOSITIF DE SOUDAGE DE CONNEXIONS DE COMPOSANTS POUR MONTAGE EN SURFACE.

Publication

**EP 0439546 A1 19910807 (DE)**

Application

**EP 89912626 A 19891020**

Priority

EP 88117480 A 19881020

Abstract (en)

[origin: WO9004912A1] According to a process for soldering the leads of SMD components (3) on a printed circuit board (1), a surface structure is formed on the printed circuit board (1) in such a way that depressions are located where the leads are to be soldered. The SMD components (3) are placed with their leads (31) in the depressions filled with solder.

Abstract (fr)

Selon un procédé de soudage des connexions de composants (3) pour montage en surface sur une carte de circuits imprimés (1), on forme sur la carte de circuits imprimés (1) une structure en surface telle que des dépressions sont situées aux endroits où les connexions doivent être soudées. Les composants (3) pour montage en surface sont posés avec leurs connexions (31) dans les dépressions remplies de soudure.

IPC 1-7

**H05K 3/34**

IPC 8 full level

**H05K 3/34** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H05K 3/3421** (2013.01); **H05K 3/3452** (2013.01); **H05K 3/3485** (2020.08); **H05K 2201/09118** (2013.01); **H05K 2201/09472** (2013.01); **H05K 2201/09909** (2013.01); **H05K 2201/10689** (2013.01); **H05K 2203/0191** (2013.01); **H05K 2203/0568** (2013.01); **H05K 2203/166** (2013.01); **Y02P 70/50** (2015.11)

Citation (search report)

See references of WO 9004912A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 9004912 A1 19900503**; EP 0439546 A1 19910807

DOCDB simple family (application)

**EP 8901259 W 19891020**; EP 89912626 A 19891020